

東レ・ダウコーニング株式会社
 東京都千代田区丸の内 1-1-3
 AIG ビル 〒100-0005
 TEL:03-3287-8300 (代表)
 FAX:03-3287-8460

2010年2月10日

次世代パワー半導体向け新技術を開発

nano tech 2010 に NEDO と共同展示

東レ・ダウコーニング株式会社（本社：東京都千代田区／代表取締役社長・COO：大志万 俊夫）は、NEDO（独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構）から委託された「超ハイブリッド技術開発」プロジェクトに参加しています。このたび、当プロジェクトで取り組んできた次世代パワー半導体向け新素材の研究開発成果について、2月17日（水）より東京ビッグサイトで開催される「nano tech2010 国際ナノテクノロジー 総合展・技術会議」の、NEDO ブース内にて発表する運びとなりました。

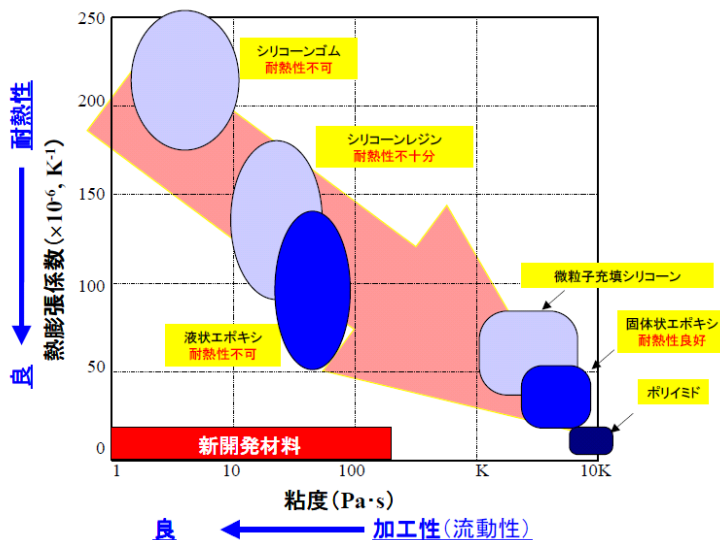
当社のケイ素化学技術を駆使した当研究開発を通じ、次世代パワー半導体の実用化に貢献する優れた特性を持つ実装用材料の基盤技術開発に成功しました。今回開発した技術を応用し製品化をすすめることで、次世代パワー半導体の省エネ化、小型化、製造コスト削減などに寄与します。

今回の当社の展示は国家プロジェクトの研究成果の公開を目的とし、研究開発中の次世代エネルギーや技術の認知度向上と産業界への貢献を目指しています。

【展示内容】

① 次世代パワー半導体向け超耐熱性・高熱伝導性ポリシロキサン材料

ポリシロキサンと機能性無機微粒子を制御して複合化させる超ハイブリッド技術により、「加工のしやすさ」と、250度での連続使用を可能にする「耐熱性の高さ」という相反機能を解消し、新しい封止材料の基礎技術の開発に成功しました。



② 熱伝導性ポリシロキサン用高性能無機微粒子の開発

東京大学大学院新領域創成科学研究科、大島研究室と共同研究をすすめ、超臨界流体技術を応用し、安価で入手可能な原料から機能性微粒子を合成する手法を開発しました。微粒子のポリシロキサンへの配合が容易になり、パワー半導体の放熱材に適した新素材の開発に役立ちます。

【nano tech2010 国際ナノテクノロジー 総合展・技術会議 概要】

- ・ 日 時：2010年2月17日(水)～19日(金) 10:00 - 17:00
- ・ 会 場：東京ビッグサイト東 4・5・6 ホール & 会議棟
- ・ 出展ブース：N-01

■東レ・ダウコーニング株式会社について

1966年、高分子化学のパイオニアである東レと、世界のシリコン技術革新をリードするダウコーニング社の合併により事業を開始。膨大な研究蓄積を基盤に、最新かつマーケットニーズに即応したシリコンを中心とした機能性素材の開発を行い、さらに顧客企業のグローバル化に呼応して、ダウコーニングとの協力体制のもと世界各所において製品および関連サービスを提供しています。

現在、ダウコーニングは世界で2万5千を超す顧客企業に対応、7千以上の製品およびサービスを提供する、ケイ素関連技術とその革新のグローバル・リーダーです。

本件に関するお問い合わせ先

●報道関係の方からのお問い合わせ

東レ・ダウコーニング株式会社

東京都千代田区丸の内一丁目1番3号 AIG ビル

Web : www.dowcorning.co.jp

広報担当：高杉記子 TEL : 03-3287-8439 / FAX : 03-3287-1203

E-mail : noriko.takasugi@dowcorning.com

または

新事業本部 B & T I 部 マーケティンググループ

原崎 崇： TEL : 03-3287-8324 / FAX : 03-3287-1065

E-mail : takashi.harasaki@dowcorning.com

●読者からの製品に関するお問い合わせ

上記、原崎 崇 (新事業本部 B & T I 部 マーケティンググループ)